**附件2：**

**2021年中国国际大数据产业博览会**

**参展企业信息征集表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | **（中文）：****（英文）：** |
| 企业简介 | **（500字内）** |
| 企业图片  | **（企业全景图、企业LOGO）** |
| 参展展品 | **（中文、英文名称）** |
| 产品标签（请选择3人以内） | **人工智能：**□机器人、□智能客服、□智能驾驶、□无人机、□深度学习、□智能识别**智慧城市：**□城市大脑、□数字孪生、□时空信息平台、□智慧环保、□智慧家居、□智慧安防、□智慧旅游、□智慧交通、□智慧教育、□智慧医疗、□智慧能源**信息通信：**□5G、□电信运营商、□智能通信终端、□通讯设备**电子商务：**□新零售、□跨境电商、□电商直播**乡村振兴：**□数字乡村、□智慧农业、□农村创新创业**虚拟成像：**□VR、□AR、□全息投影**数字经济：**□产业数字化、□数字产业化、□数字生态、□数字基础设施、□共享经济**网络安全：**□数据安全、□网络设备安全、□移动网络安全、□工控安全、□安全监测与舆情、□网络安全解决方案**智能制造：**□工业互联网、□智慧工厂、□智能制造系统、□数字化设计与仿真模拟**物联网：**□车联网、□可穿戴设备、□边缘计算、□物联网-装置与技术、□物联网-系统及软件开发、□物联网-系统集成应用、□物联网-智能终端**区块链：**□主权区块链、□联盟链、□公有链、□私有链、□区块链应用、□区块链技术开发**量子技术：**□量子计算机、□量子系统、□量子平台**数据库：**□国产数据库、□数据库技术、□数据仓库、□数据库安全产品**数据中心：**□数据中心硬件、□数据中心软件、□数据中心-规划设计、□数据中心-衍生生态、□数据中心-维护与升级**集成电路：**□芯片、□IC设计、□半导体、□集成电路-电子元器件**媒体融合：**□融媒体、□智慧媒体平台、□移动直播、□短视频**金融科技：**□征信、□移动支付、□互联网金融、□数字货币、□金融风控、□金融监管、□金融科技**数字政府：**□政务云、□政务网、□政务数据开发共享、□政务大数据平台**云计算：**□云服务器、□云安全、□云存储、□云服务**软件服务：**□软件开发与应用、□软件维护与升级、□硬件技术支持**大数据分析挖掘：**□数据挖掘、□数据分析、□数据可视化、□数据处理、□用户/企业画像、□算法平台、□敏捷BI**数据要素流通：**□数据交易/交换、□数据开发共享、□数据服务、□数据管理**特殊主题：**□产业园区与综合试验区 |
| 产品介绍 | **（500字内）** |
| 产品图片 | **（小于100KB，分辨率比例1080\*607）** |
| 参展人姓名 |  | 性别 |  |
| 职务 |  | 手机号 |  |
| 身份证号 |  | 照片 | **（一寸免冠照）** |
| 参展人姓名 |  | 性别 |  |
| 职务 |  | 手机号 |  |
| 身份证号 |  | 照片 | **（一寸免冠照）** |

注：企业及产品信息用于展会后台信息填报，参展人员信息用于办理入场证件，请准确填写。此表格请于4月26日前回传此表至member@zhzsia.org.cn。谢谢！